目次

はじめに p/n Junction Shockleyの電流方程式



応用編: 先端デバイスの特性 ^{短チャネル効果} Non-Quasi-Static効果 ノイズ 高調波ひずみ Y-パラメタ特性

基本方程式



すべてのデバイス特性はポテンシャルの関数



$$\int_{0}^{L} I_{ds} dy = W \mu \int_{0}^{V_{ds}} Q_{n} dV \implies V_{ds} = \mu \frac{W}{L} C_{ox} \left[\left(V_{gs} - V_{th} \right) V_{ds} - \frac{1}{2} V_{ds}^{2} \right]$$
$$V_{th} = 2\Phi_{B} + \frac{\sqrt{2E_{Si}qN_{sub}}2\Phi_{B}}{C_{ox}}$$

しきい値条件

Poisson's Equation + Gauss's Law

$$C_{\text{ox}}(V'_{\text{G}} - \phi_{\text{S}}(y)) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\text{s}} q N_{\text{sub}}}{\beta}} \left[\exp\{-\beta(\phi_{\text{S}}(y) - V_{\text{bs}})\} + \beta(\phi_{\text{S}}(y) - V_{\text{bs}}) - 1 + \frac{n_{\text{p0}}}{p_{\text{p0}}} \left\{ \exp\{\beta(\phi_{\text{S}}(y) - \phi_{\text{f}}(y))\} - \exp\{\beta(V_{\text{bs}} - \phi_{\text{f}}(y))\} \right\}^{-\frac{1}{2}} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

しきい値条件: Carrier濃度が基板濃度と等しくなった時

$$n = n_{\rm i} \exp \frac{q(\phi - \phi_{\rm n})}{kT} = n_{\rm p0} \exp \left(\frac{q \phi_{\rm S}}{kT}\right)$$
$$n_{\rm p0} p_{\rm p0} = n_{\rm i}^{2} : \text{Moss-Action Law}$$
$$\implies \phi_{\rm s} = \frac{2kT}{q} \ln \left(\frac{N_{\rm sub}}{n_{\rm i}}\right) = 2\Phi_{\rm B}$$

しきい値条件下: n_{p0}/P_{p0} の項は無視できる $C_{ox}(V'_{G} - 2\Phi_{B}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{s} qN_{sub}}{\beta}} \left[\beta (2\Phi_{B}) - V_{bs}) - 1\right]^{\frac{1}{2}}$ I Description $V_{th} = V_{tb} + 2\Phi_{B} + \gamma \left[\beta (2\Phi_{B}) - V_{bs}) - 1\right]^{\frac{1}{2}}$ $\gamma = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{s} qN_{sub}}{\beta}} / C_{ox}$: Body-Effect Coefficient

しきい値電圧





2次元効果: charge-sheet近似の破綻

2次元デバイスシミュレーション結果



観測される短チャネル効果

(1) Vth - Lgate 特性



(III) Subthreshold Swing





M.Miura-Mattaush and H. Jacobs, Japn J. Appl. phys., vol. 29, p. L2279, 1990.



Gauss's Law:
$$-\int_{A}^{B} E_{y1} dx + \int_{C}^{D} E_{y2} dx + \int_{D}^{A} E_{x} dy = -\int \frac{Q_{s}}{\varepsilon_{si}} dy$$

$$E_{x}dy + W_{d}(E_{y}2-E_{y}1) = \frac{(Q_{b}+Q_{i})}{\varepsilon_{si}}dy; \quad E_{x}+W_{d}\frac{dE_{y}}{dy} = \frac{(Q_{b}+Q_{i})}{\varepsilon_{si}}$$
$$\Delta V_{th,SC} = \frac{\varepsilon_{si}}{C_{ox}}W_{d}\frac{dE_{y}}{dy}$$

ポテンシャル分布を2次関数近似

$$\frac{dE_y}{dy} = \frac{2(V_{bi} - 2\Phi_B)}{(L_{gate} - PARL2)^2} (SC1 + SC2 \times V_{ds} + SC3 \frac{2\Phi_B}{L_{gate}})$$

$$PARL2, SC1, SC2, SC3 : モデルパラメタ$$

逆短チャネル効果



原因:チャネルエンジニアリング

• Retrograded Case: Impurity Pile-Up





Pocket-Implanted Case





Retrogradedの場合



M. Suetake et al. Proc. SISPAD, p.207, 1999.



H. J. Mattausch et al., Appl. Phys. Lett., 80, p. 2994, 2002.



不純物のPileup現象



Pocket-Implantの場合







D. Kitamaru et al., Proc. SISPAD, p. 392, 2001.

解析式の導出





H. Ueno et al., IEEE Trans. Electron Devices, vol. 49, p. 1783, 2002.







1.High Frequency 2.Noise Influence 3.Non-Linearity

PLLの特性

Time-Domain Analysis

Frequency-Domain Analysis







<u>Non-Quasi-Static効果</u>



Quasi-Static Approximation: spontaneous carrier response

キャリア応答遅延モデル=NQSモデル





T.Okagaki et al., IEEE EDL, vol. 23, pp. 154, 2002

NQS効果のモデリング



N. Nakayama et al., IEE Electron. Lett., 40, p. 276, 04.

HiSIM2 81

シミュレーション結果



D. Navarro et al., IEEE TED, p. 2025, 2006.

MOSFETにおけるノイズ







¢

1/f ノイズの測定系



1/f/イズの起源



たとえば: K. K. Hung et al. IEEE Trans. ED, 37, p.1323, 1990.

Monte Carloシミュレーション



ノイズは主に酸化膜でのTrap/Detrapによって生じる。

H. Ueno et al., Appl. Phys. Let., 78, p.380-382, 2001.





測定特性は必ずしも1/fではない。

原因を解明:ソースとドレイン電極を入れ替えた測定 *L*g=1μm (nMOSFET)

Linear Condition

Saturation Condition



Lg=0.13μm (nMOSFET)



L_g=1μm (nMOSFET)



Waferの 測定 結果



S. Matsumoto et al., IEICE, Trans. Electron., vol. E88 - C, Feb, 2005.

表面ポテンシャルモデルHiSIMでのモデル化

$$S_{l_{ds}}(f) = \frac{W_{g}N_{t}}{qL_{g}^{2}\eta f} kT \int_{0}^{L-\Delta L} \left(\frac{l_{ds}}{W_{g}}\right)^{2} \left(\frac{1}{N(x)} \pm \alpha \mu\right)^{2} dx$$

$$N_{Ns} = \frac{N[C]}{N_{Ns}}$$

$$N_{i} = \frac{N_{i}}{N_{i}}$$

$$N_$$

[Model Parameters]

Trap Density: $N_{\text{trap}} = N_t(E_f)/\eta \ [eV^{-1}cm^{-3}][cm] = [eV^{-1}cm^{-2}]$ Scattering Coeff.: α [Vs]

Flicker Noiseはキャリアのチャネル内分布によって決まる。

1/f/イズの測定値との比較





▶ チャネル内キャリアの分布が1/fノイズ特性を決定している。

S. Matsumoto et al., IEIEC T E, E88-C, p. 247, 2005.

MOSFETにおけるノイズ



Noise Figure測定



Thermal/イズの起源



van der Ziel Description based on Nyquist's Theorem

$$S_{\rm id} = \frac{4kT}{L_{\rm eff}^2 I_{\rm ds}} \int g_{\rm ds}^2(y) dy$$
$$= 4kTg_{\rm ds0}\gamma$$

 $g_{ds}(y)$: Channel Conductance g_{ds0} : at $V_{ds}=0$ γ : Noise Coefficient

測定値とHiSIM計算結果の比較



モデルパラメタはなし

S. Hosokawa et al., Appl. Phys. Lett., 87, 092104, 2005.

ノイズ係数の考察



- Knoblinger et al. (2001): Hot Electron Contribution
- Jamal Deen et al. (2002): Channel Length Modulation
- Scholten et al. (2002): Velocity Saturation

測定特性の解析



異なるテクノロジーの比較



- first γ reduction and increase in the saturation region
- no drastic increase of γ
- γ minimum increase from 2/3

V_{th}shiftとの関係



MOSFETにおける更なるノイズ

- 1/f Noise
 Thermal Noise
 Induced Gate Noise
 Cross-Correlation Noise
- Shot NoiseJunction Noise



$$I_{ds}$$

 I_{ds}
 I_{ds} (DC)

Noise Spectral Intensity

$$S_{i_d} = \frac{\overline{\Delta i_{ds}^2}}{f}$$

Induced Gate & Cross Correlation Noise



$$S_{i_{g}} = \int |\Delta i_{g}|^{2} dx = \int (\Delta I_{1}' + \Delta I_{2}')^{2} \Delta v^{2} dx : \text{induced gate}$$
$$S_{i_{g}i_{d}} = \int \Delta i_{g}^{*} \Delta i_{d} dx = \int (\Delta I_{1}' + \Delta I_{2}')^{*} (\Delta I_{2}') \Delta v^{2} dx : \text{cross - correlation}$$

モデルパラメタなし

T. Warabino et al., Proc. SISPAD, p. 158, 2006.

測定値の考察



A. J. Scholten et al., Tech. Dig. IEDM, p. 867, 2003. T. Warabino et al., Proc. SISPAD, p. 158, 2006. 高調波ひずみ





HiSIM2 107



低周波における高調波ひずみ



高周波における高調波ひずみ



Carrier transit delay dominates the HD characteristics.

D. Navarro et al., SISPAD, p. 259, 05

HiSIM2 110

Y-パラメタ特性



小信号解析

١





$$\begin{bmatrix} i_{g} \\ i_{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{gg}(\omega) \ \mathbf{Y}_{gd}(\omega) \\ \mathbf{Y}_{dg}(\omega) \ \mathbf{Y}_{dd}(\omega) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{g} \\ v_{d} \end{bmatrix}$$

Admittance Matrix

$$Y_{\alpha\beta} = \operatorname{Re}(Y_{\alpha\beta}) + \operatorname{Im}(Y_{\alpha\beta})$$

S-Parameters : Power Measurement



Y-Parameters : Admittance

$$\begin{bmatrix} i_{g} \\ i_{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11}(\omega) \ Y_{12}(\omega) \\ Y_{21}(\omega) \ Y_{22}(\omega) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{g} \\ V_{d} \end{bmatrix}$$

Admittance Matrix

$$Y_{\alpha\beta} = Re(Y_{\alpha\beta}) + Im(Y_{\alpha\beta})$$

Analytical Description:

 $Y_{11}(\omega) = \omega^2 R_g C_{gg}^2 + j \omega C_{gg}$ $Y_{21}(\omega) = g_m - \omega^2 R_g C_{gg} (C_m + C_{gd})$





H. Kawano et al., Digest Microwave Symp., P. 2121, 2002.

HiSIM2 115

NQS効果の検証



HiSIM2 116

大信号モデルの小信号モデルへ拡張



K. Machida et al., SiRF., p. 57, 2006.

Y-パラメタ特性















表面ポテンシャルモデルの特徴 *I = qnµE* すべての物理量が同じルーツ(ポテンシャル)で計算されている 「 デバイス物理の基本

RFデバイスの特性評価

✓ ノイズ
 ✓ 高調波ひずみ
 ✓ Y-パラ

RFデバイス特性は電流 電圧特性で決まる

回路モデルへの要求

✓ デバイス特性がコンパクトに記述されている
 ✓ すべての観測される現象がモデル化されている
 ✓ デバイス特性と回路性能の関係が予測できる
 ✓ 大規模回路がシミュレーションできる
 ✓ すべての市販しミュレータに組み込まれている



- ✓ 先端MOSFETの性能向上
- ✓ これを十分に利用できる信頼性の高い回路モデル
- ✓回路モデルがBSIMからPSPあるいはHiSIMに移行